

NT 004

PROCEDURE DI MONTAGGIO

1 Mantenere puliti tappetini esd tavoli.

2 Indossare bracciale collegato a massa

3 Indossare scarponcini antistatici

4 Indossare indumenti e camice antistatico.

6 Durante ogni fase di lavorazione, per spostare parti da una produzione all'altra utilizzare contenitori con caratteristiche ESD. non usare i carrelli per il trasporto.

Fare uso del campione o della foto solo a scopo illustrativo generale.

Attenersi scrupolosamente alla documentazione aggiornata topografico e distinta, ATTENZIONE ALLE NOTE.

Prima di iniziare il montaggio, i circuiti stampati dovranno SUBIRE un trattamento BAKING:

105° a 125° C. per durata 4/6 ore

I circuiti stampati sono molto sensibili all'umidità (sono igroscopici) ed in funzione delle loro caratteristiche costruttive (tipo di laminati, numero di layers, quantità di fori, spessore, ecc), se non ben asciugati durante la fase di costruzione del c.s., sono in grado, se sottoposti a shock termici quali le temperature dei processi di saldatura, in particolare quella di rifusione, di assorbire una quantità di umidità tale da comprometterne l'integrità.

I difetti più comuni che potrebbero conseguire sono le delaminazioni tra i layer interni del PCB che non sempre sono di facile individuazione, compreso il popcorn.

Il medesimo fenomeno si presenta anche per tutta una serie di componenti elettronici, soprattutto "attivi", quali integrati, Microprocessori, Led, CPLD etc..

Le norme inerenti la gestione, il trattamento e lo stoccaggio dei componenti sensibili a tale fenomeno sono due : la **IPC-J-STD-033 per i componenti e la più recente **IPC-1601**, inerente i PCB.**

